

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

江苏艾森半导体材料股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2024-009

| | |
|----------------|---|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他 |
| 参与单位名称 | 华泰证券、东北证券、申万菱信基金、炬诚资产 |
| 时间 | 2024年7月11日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司 接待人员姓名 | 常务副总经理、董事会秘书：陈小华 证券事务代表：徐雯 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>问题一：请问先进封装和晶圆制造领域市场规模如何？</p> <p>回答：根据中国电子材料行业协会（CEMIA）统计数据，2023年中国集成电路后道封装（含传统封装与先进封装）用湿化学品市场规模14.0亿元，随着晶圆制造工艺的不断提升，对与之配套的封测技术同步要求提高，传统封装技术的发展将趋于平稳，先进封装技术的应用将进一步加强，对湿化学品的需求量也将随之增加，预计2025年中国集成电路后道工艺用湿化学品市场规模将达到16.3亿元。</p> <p>2023年中国集成电路前道晶圆制造用湿化学品市场规模58.8亿元，预计到2025年将增长至69.8亿元。</p> <p>综合封装领域与晶圆制造来看，2023年中国集成电路用湿化学品总</p> |

| | |
|-----------------------|--|
| | 体市场规模达到 72.8 亿元，预计 2025 年将增长至 86.1 亿元。 |
| 关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明 | 无 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2024 年 7 月 11 日 |